【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年6月7日(2022.6.7)

【国際公開番号】WO2019/231919
【公表番号】特表2021-525956(P2021-525956A)
【公表日】令和3年9月27日(2021.9.27)
【出願番号】特願2020-566268(P2020-566268)
【国際特許分類】
H01L 31/02(2006.01)
H01L 23/02(2006.01)
【FI】
H01L 31/02 B
H01L 23/02 F

【手続補正書】
【提出日】令和4年5月28日(2022.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
従って、より高温の熱仕様を有し、回折を減少させるためにより肉薄の外形状を提供する、従来技術のチップパッケージが必要とされている。
この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
（特許文献）
（特許文献１） 米国特許出願公開第２０１３／００５０２２７号明細書
（特許文献２） 米国特許出願公開第２０１１／０１０８３０８号明細書
（特許文献３） 米国特許出願公開第２００７／０１４６７１６号明細書